

その技術が、 世界の"はたらく"を変える。

第1回 応募締切 10/5(月) 正午

併願応募OK / 専攻不問 / 第2回締切 11/2(月)・12/14(月) 正午

- ・なるべく第1回目のご応募をお勧めいたします。
- ・インターンシップ詳細情報は、右側QRコードもしくは、弊社マイページ内にある過去インターンバナーよりご確認ください。



名称	実施日程	実施方法	実施期間	応募締切
＜ソフトウェア＞ ICT・アプリ開発・組み込みSW技術開発	11月16日(月)～11月20日(金)	対面	5days	第1回：10月5日(月) 正午
	12月7日(月)～12月11日(金)	対面	5days	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ソフトウェア＞ 企業での業務DXの本質に迫る	11月9日(月)～11月10日(火) 12月14日(月)～12月15日(火)	対面	2days	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ソフトウェア＞ AIと作るソフトウェア開発	12月14日(月)～12月15日(火)	対面	2days	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ソフトウェア＞ AI研究技術開発	12月2日(水)～12月4日(金)	対面	3days	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ソフトウェア＞ 組み込み開発プロセスの本質に迫る	10月27日(火)、10月28日(水)、 11月26日(木)	対面	1day	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ハードウェア/エレクトロニクス＞ エレクトロニクス開発の本質に迫る	10月29日(木)	対面	1day	第1回：10月5日(月) 正午
＜ハードウェア＞ メカ設計開発の本質に迫る	10月23日(金) 11月24日(火)	対面	1day	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ハードウェア＞ 市場のマシンデータを活用した複合機開発体験ワークショップ	10月26日(月) 11月25日(水)	対面	1day	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜ハードウェア/マテリアル＞ モノ作り体感型ワークショップ	11月27日(金) 12月9日(水)	対面	1day	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午
＜マテリアル＞ 濃厚型技術体感セミナー	11月6日(金) 1月15日(金)	オンライン	1day	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：12月14日(月) 正午
＜知的財産＞ 技術とビジネスを繋ぐキーパーソンになろう	12月4日(金)	対面	1day	第1回：10月5日(月) 正午 第2回：11月2日(月) 正午

● FUJIFILM Career Square 2028

＜本チラシ限定用のマイページ登録・ログイン用＞

- 本チラシをご覧いただいた方の履歴を把握するため、右側のQRコードからマイページへの登録をお願いいたします。既に登録済みの方もログインをお願いします。
(※登録者には優遇措置を予定！)

